



FUJISOFT

2018年10月31日
富士ソフト株式会社

富士ソフト、超高解像度 8K 映像技術とエッジ AI 技術を大公開！
～2018年11月14日～16日開催の Embedded / IoT Technology 2018 に出展～

富士ソフト株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員:坂下 智保)は、11月14日(水)よりパシフィコ横浜で開催される「ET & IoT Technology 2018」(以下 ET2018)に出展いたします。

今回の出展では、『組み込みはエッジだけじゃない～未来を変える、富士ソフトのハイブリッドテクノロジー～』をテーマに、エッジからクラウドに渡る組み込み製品開発に必要な最新の技術を展示いたします。今年12月1日に開始される新 4K8K 衛星放送、2020年向け製品に対応した「超高解像度 8K 映像ソリューション」、最先端画像認識技術「エッジ AI ソリューション」を中心としたデモや当社のノウハウの詰まったエッジ AI の講演を交え、技術開発に役立つアイテムを盛りだくさんご用意しています。

【ET & IoT Technology 2018 出展について】

会期: 2018年11月14日(水)～16日(金) 10:00～17:00
※15日(木)は18:00まで
会場: パシフィコ横浜 展示ホール A(A-07)
(<http://www.pacifico.co.jp/visitor/access/tabid/236/Default.aspx>)
主催: 一般社団法人 組み込みシステム技術協会
URL: <https://www.fsi-embedded.jp/et2018>



【出展内容】

映像ソリューション

1. 4K+高画質化+高速 H.265 アクセラレーションカード

「映像劣化防止技術」(Gizmo International 社)と「超低遅延 H.265 エンコーダ」(System On Chip 社)を組み合わせた映像配信技術を、4K 80 インチの大型ビジョンで紹介いたします。

※Gizmo International: <http://gizmo-inter.com/>
System On Chip: <http://www.soctechnologies.com/>

2. 超高解像度 8K 映像ソリューション

「超高解像度 8K 対応 H.264 エンコーダ ボード」(System On Chip 社)を用いた 8K 映像技術を、8K 70 インチの大型ビジョンで紹介いたします。

エッジ AI ソリューション

- ・エッジ AI 開発における初期検討からデータ収集～実装まで、POC(概念実証)をサポートする「エッジ AI コンサルテーション」サービスと、FPGA、CPU、GPU など様々なエッジ用 AI チップを使った「エッジ AI 実装プラットフォーム」の紹介。また、クラウド AI とエッジ AI の連携によるハイブリッド AI 技術を紹介いたします。
- ・FPGA による高速 3 次元画像処理技術の「Stereo Vision IP Suite」と「FPGA-AI」を組み合わせた「人物の特定エリア侵入を検知するライブデモ」を展示します。



<4K+高画質化+高速 H.265 アクセラレーションカード>



<超高解像度 8K 映像ソリューション>



<Stereo Vision IP Suite>



FUJISOFT

IoT／組み込み機器開発 トータルソリューション

IoTを構築する際に必要な組み込み技術・製品を一挙展示。全世界の最新かつ最先端の組み込み製品を紹介します。
(展示製品例:IPコア、評価ボード、産業用PCなど)

製品・パートナー選定ソリューション

・AI関連50社を一堂で紹介！世界の製品が探せるマッチングサイト「EIPC」



・組み込み製品がオンラインで買えるECサイト「組市.com」



＜カンファレンス＞

「エッジAIにおける学習データの重要性和導入形態の多様性」

～組み込み向けエッジAI特有の要件とそれに対応する最新技術を使ったAI導入・実装提案について～

開催日時:11月15日(木)13:30～14:15
開催場所:パシフィコ横浜 展示ホール セミナー会場C
講師:富士ソフト株式会社 プロダクト事業本部
EP事業推進部 商品開発室 室長
薬師寺 秀徳



組み込み分野でエッジAIの導入・運用が本格的に始まろうとしています。特定用途AIにおける学習データの「質」の重要性が再認識され、エッジAIの実装形態にも、クラウドAIを組み合わせたハイブリッドAIが求められるなど多様化しており、最適なエッジAIの導入が検討課題になってきています。このような組み込み向けエッジAI特有の実装・導入要件や最新AI技術動向とともに、これからエッジAI導入を具体的に検討していくために必ず押さえておくべき重要なポイントを解説します。

※記載している会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

以上

この件に関するお問い合わせ

■ニュースリリースについて
コーポレートコミュニケーション部
担当:西元・蓮見
〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3
TEL:050-3000-2735
FAX:03-5209-6085

■出展について
プロダクト事業本部
エンベデッドプロダクト事業推進部
ディストリビューションビジネス室
TEL:050-3000-2102
FAX:045-664-2666
E-MAIL:et-solution@fsi.co.jp